

东田嵌入式无风扇工控机

DTB-3180-Q670E



更多产品信息
请扫描二维码



主要特性

intel Q670E
芯片组

支持intel Core
12/13代CPU

最大支持64G内存

1个DP接口
1个VGA接口
1个DVI-D接头

6个intel千兆网口
可选4个POE

6个USB3.2
2个USB2.0

4个COM口
(2个RS232/422/485)

1个PCIE × 16

买工控·选**东田**，总有一款适合您

地址: 浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址: www.dongtiantech.com
电话: 0571-88855790/91

更多产品信息
请扫描二维码



具体参数

芯片组	Intel Q670E
CPU	LGA1700,支持intel 12/13代 Core i3/i5/i7/i9处理器, 65W/35W TDP
内存	2个SODIMM内存插槽 DDR5 4800MHz SDRAM, 高达64GB
显示	1个VGA、1个DVI-D、1个DP
存储	2个内部SATA端口, 用于2.5英寸HDD/SSD安装,支持RAID 0/1; 1个M.2 M-key 2280 (PCIe Gen4x4) 用NVMe SSD;
网络	带螺钉锁1个i219-LM+5个2.5G I225-IT端口3-6可选POE+
COM	2个RS232/422/485(COM1/2)、2个RS232
扩展	1个PCIe × 16(支持NVIDIA RTX系列GPU卡高达130W TDP)、1个全尺寸mini PCIe、 1个M.2 B-key 3042/3052带SIM卡座用于4G/5G模块、1个MezIO 扩展接口
USB	1个USB3.2 Gen2x2(20 Gbps) type-c, 4个USB3.2 Gen2x1 (10 Gbps) type-A, 2个USB3.2 Gen1x1(5 Gbps) type-A, 2xUSB2.0
I/O前面板接口	6个USB3.2(type-A)、2个usb2.0、1个type-C (USB3.2)、1个VGA、1个DVI-D、 1个DP、6个LAN
I/O后面板接口	1个MezIO 扩展接口、4个COM、1个3.5MM耳机接口、1个3PIN远程开关接头、 1个3pin 8-48V凤凰端子头 DC IN
电源	8-48V DC IN
机箱尺寸	240*225*110.5MM(宽深高)
整机重量	约3.89Kg
支持系统	Windows10、Linux

